

PCN # 20130903003
一部製品について ASE 社上海,TI-Taiwan,JCAP 社組立 / 検査サイト追加認定

お客様各位

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、変更前の製品サンプル作製は行わない為、変更品評価用サンプルご入用の場合には、事前に本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。変更時期につきましては、次頁以降の変更時期をご参照下さい。お客様の受領連絡及びサンプル依頼は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

PAGE 2:

Attachment: 1

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。変更内容詳細は下記を参照ください。

PCN 番号:	20130903003	PCN 日付:	09/12/2013																								
表題:	一部製品について ASE 社上海, TI-Taiwan, JCAP 社組立/検査サイト追加認定																										
PCN 詳細																											
変更内容:																											
TI は、“Product Affected” セクション記載の製品について、追加組立/検査サイトとして ASE 社上海, TI-Taiwan, JCAP 社サイトの認定を連絡します。現行組立サイトは、下記 “Changes to Product Identification” 表の通りです。組立の違いは下記の通りです。 Group 1 Device: HNT to ASES <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Hana-Thai(HNT)</th> <th>ASE-Shanghai(ASES)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wire type</td> <td>1.0 Mil Au</td> <td>1.0 Mil Cu</td> </tr> <tr> <td>Mold Compound</td> <td>450179</td> <td>EN2000515</td> </tr> </tbody> </table> Group 2 Device: AMKOR K1 to TITL <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AMKOR Korea(K1)</th> <th>TI-Taiwan(TITL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lead finish</td> <td>Matte Sn</td> <td>NiPdAu</td> </tr> <tr> <td>Mold Compound</td> <td>101319570</td> <td>4205442</td> </tr> </tbody> </table> Group 3 Device: STS to JCAP <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>STATS ChipPAC(STS-AT)</th> <th>JCAP-AT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bump Site</td> <td>STS-BP</td> <td>JCAP-FAB</td> </tr> </tbody> </table> Test coverage 内容、条件は、現行テストと一致しており、テスト生産性認定試験(Test MQ)にて検証されます。					Hana-Thai(HNT)	ASE-Shanghai(ASES)	Wire type	1.0 Mil Au	1.0 Mil Cu	Mold Compound	450179	EN2000515		AMKOR Korea(K1)	TI-Taiwan(TITL)	Lead finish	Matte Sn	NiPdAu	Mold Compound	101319570	4205442		STATS ChipPAC(STS-AT)	JCAP-AT	Bump Site	STS-BP	JCAP-FAB
	Hana-Thai(HNT)	ASE-Shanghai(ASES)																									
Wire type	1.0 Mil Au	1.0 Mil Cu																									
Mold Compound	450179	EN2000515																									
	AMKOR Korea(K1)	TI-Taiwan(TITL)																									
Lead finish	Matte Sn	NiPdAu																									
Mold Compound	101319570	4205442																									
	STATS ChipPAC(STS-AT)	JCAP-AT																									
Bump Site	STS-BP	JCAP-FAB																									
変更理由:																											
供給能力確保																											
外観, 寸法, 機能, 品質, 信頼性(positive / negative)に関する懸念事項:																											
なし																											

注記)

- 本資料は英語原文(一部)の日本語訳になりますが、TI の公式文書はあくまで英語原文になります。英語原文と日本語訳に齟齬がある場合には、英語原文が優先されます。
- 上記項目以外、本資料に日本語訳が記載されていない項目については英語原文を参照ください。

原文のみ記載の項目例:

- Proposed 1st Ship Date (変更品出荷開始予定日)
- Last date to order / Last date to ship (最終受注日/最終出荷日)
- Estimated Sample Availability (サンプル入手可能予定時期)
- Change Type (変更項目タイプ)
- Changes to product identification resulting from this PCN (本変更による製品識別の変更)
- Product Affected (対象製品)
- Qualification Data (認定試験データ)
- Appendix (付属資料) 等